

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年7月13日(2017.7.13)

【公開番号】特開2016-72372(P2016-72372A)

【公開日】平成28年5月9日(2016.5.9)

【年通号数】公開・登録公報2016-027

【出願番号】特願2014-198804(P2014-198804)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/30 (2012.01)

H 01 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 L

B 24 B 37/04 V

H 01 L 21/68 P

【手続補正書】

【提出日】平成29年5月31日(2017.5.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0057】

押し上げ機構77は、リテナリング3に接触する押し上げピン78と、押し上げピン78を上方に押す押圧機構としてのばね(図示せず)と、押し上げピン78およびばねを収容するケーシング79とを備えている。押し上げ機構77は、押し上げピン78がリテナリング3の下面に対向する位置に配置される。研磨ヘッド1が下降すると、リテナリング3の下面が押し上げピン78に接触する。ばねは、リテナリング3を押し上げるのに十分な押圧力を有している。したがって、図6に示すように、リテナリング3は押し上げピン78に押し上げられ、ウェーハWよりも上方の位置まで移動される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0059

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0059】

次に、リテナリングステーション75と搬送ステージ76を用いたウェーハリリース動作について説明する。研磨されたウェーハWを保持している研磨ヘッド1は、リテナリングステーション75の上方の所定位置に移動する。次いで、研磨ヘッド1が下降し、図6に示すようにリテナリング3がリテナリングステーション75の押し上げ機構77により押し上げられる。研磨ヘッド1が下降しているとき、搬送ステージ76が上昇し、リテナリング3に接触することなく研磨ヘッド1の真下まで移動する。